

2011-2016年中国智能卡芯片行业市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2016年中国智能卡芯片行业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/yingjian1111/M365104P11.html>

【报告价格】纸介版7800元 电子版8300元 纸介+电子8800元

【出版日期】2011-11-30

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

→报告说明

博思数据研究中心发布的《2011-2016年中国智能卡芯片行业市场分析与投资前景研究报告》共十三章。介绍了智能卡芯片行业相关概述、中国智能卡芯片产业运行环境、分析了中国智能卡芯片行业的现状、中国智能卡芯片行业竞争格局、对中国智能卡芯片行业做了重点企业经营状况分析及中国智能卡芯片产业发展前景与投资预测。您若想对智能卡芯片产业有个系统的了解或者想投资智能卡芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

→内容简介

2010年全球IC卡市场，亚太地区约占71.5%的市场份额，其中中国市场占据全球IC卡销售收入的三分之一。2010年中国智能卡销售量为21.35亿张，同比增长8.4%；中国IC卡片销售额约81亿元，同比增长13%。在传统领域，二代身份证已经基本发放完毕；在移动通信市场，2010年中国移动通信卡销售量同比增长3.2%。在新兴应用领域，如全国统一社保卡、手机支付卡等，市场增长迅猛。2010年中国社保卡销量增长高达126.3%。社保卡市场将成为继二代身份证之后的又一重量级智能卡应用。美国是世界上半导体产业最发达的国家，但在智能卡的应用和普及上却相对滞后，主要原因在于美国的磁卡应用在全世界占首位，全面更换IC卡将投入巨大成本，因此IC卡全面替代磁条卡的进展较为缓慢。欧洲拥有以金雅拓为代表的智能卡厂商，同时拥有ST、英飞凌以及NXP等智能卡芯片厂商，推动了智能卡产业的发展，目前欧洲大多数国家都在进行EMV迁移，对智能卡的需求大增。亚太地区行业信息化的快速发展，中国、印度、日本、韩国以及其它东南亚国家对智能卡的需求极大。智能卡在电信领域的应用占据整个市场70%以上的市场份额。2009年，全球手机注册用户数量达到46亿，即全球平均每3个人中就有2个手机用户。规模庞大并不断增长的手机用户保证了对智能卡的旺盛需求。同时，无线固话、上网本、具备通讯功能的GPS终端应用的普及，以及移动支付的蓄势待发都将推动电信领域智能卡市场的增长。在中国，三大运营商大力推进3G网络以及物联网的建设是未来几年智能卡市场保持持续稳定发展的动力。中国将是智能卡巨大的潜在市场。随着我国核心芯片生产能力的不断增强，以及有关智能卡的标准和技术规范的进一步制定实施，“十二五”期间，智能卡在各领域的应用普及将会更加广泛。

我国智能卡芯片产业在“十一五”前期延续了自2000年以来快速发展的势头，虽然中期受到国际金融危机的冲击连续两年下滑，但在国内宏观经济向好和全球智能卡芯片市场复苏的带动下，2010年最终扭转了下滑局面并实现大幅增长。“十一五”期间产业所聚集的技术创新动力、市场拓展能力和资源整合活力，将为智能卡芯片产业在未来5年实

现快速发展、做大做强奠定坚实基础。过去5年成就辉煌，然而问题也不容忽视。目前从智能卡芯片技术演进路线来看，一是芯片集成度在不断提高，二是功能多样化趋势日益明显。在国际金融危机冲击下，全球智能卡芯片产业资源进行了新一轮重组，产业集中度更高。无论是主流产品市场，还是代工市场，竞争激烈程度进一步提高，产业地资金、技术的要求也越来越高。我国智能卡芯片产业虽然取得了一定进步，但是在市场规模、技术创新、工艺水平和市场占有率方面，与发达国家相比还有相当差距，有些问题已经成为产业进一步发展的瓶颈。

→报告目录

目 录

CONTENTS

第一部分 行业发展分析

第一章 中国智能卡芯片行业发展环境分析 1

第一节 经济环境分析 1

一、经济发展状况 1

二、收入增长情况 6

三、固定资产投资 18

四、存贷款利率变化 26

五、人民币汇率变化 29

第二节 政策环境分析 40

一、行业政策影响分析 40

二、相关行业标准分析 52

第三节 智能卡芯片行业发展的“波特五力模型”分析 54

一、行业内竞争 54

二、买方侃价能力 55

三、卖方侃价能力 55

四、进入威胁 56

五、替代威胁 56

第四节 影响智能卡芯片行业发展的主要因素分析 57

第二章 智能卡芯片产业发展现状分析 58

第一节 产业链产品构成 58

第二节 产业特点 58

一、产业所处生命周期 58

二、季节性与周期性 63

第三节 产业竞争分析 65

一、企业集中度 65

二、地区发展格局 66

第四节 产业技术水平 68

一、技术发展路径 68

二、当前市场准入壁垒 72

第五节 2010-2011年产业规模 77

一、产品产量 77

二、市场容量 77

第六节 近期产业政策 77

第二部分 行业市场分析

第三章 2006-2016年中国智能卡芯片需求与消费状况分析及预测 85

第一节 2006-2010年中国智能卡芯片产量统计分析 85

第二节 2006-2010年中国智能卡芯片消费量统计分析 86

第三节 2011-2016年中国智能卡芯片产量预测 87

第四节 2011-2016年中国智能卡芯片消费量预测 88

第四章 智能卡芯片下游产业发展 90

第一节 智能卡芯片下游产业构成 90

第二节 下游细分市场 110

一、发展概况 110

二、2009-2011年智能卡芯片产品消费量 112

三、未来需求发展趋势 112

第三节 下游细分市场 116

一、发展概况 116

二、产品消费模式 133

三、未来需求发展趋势 134

第四节 智能卡芯片下游产业竞争能力比较 141

第五章 2007-2016年中国智能卡芯片行业市场规模分析及预测 151

第一节 我国智能卡芯片市场结构分析 151

第二节 2007-2010年中国智能卡芯片行业市场规模分析 158

第三节 中国智能卡芯片行业区域市场规模分析 159

一、东北地区市场规模分析 159

二、华北地区市场规模分析 159

三、华东地区市场规模分析 159

四、华中地区市场规模分析 159

五、华南地区市场规模分析 160

六、西部地区市场规模分析 160

第四节 2011-2016年中国智能卡芯片行业市场规模预测 160

第三部分 行业整合分析

第六章 智能卡芯片产业链整合策略研究 163

第一节 当前产业链整合形势 163

第二节 产业链整合策略选择 174

第三节 不同地区产业链整合策略差异分析 177

第七章 智能卡芯片企业资源整合策略研究 184

第一节 智能卡芯片企业存在问题 184

第二节 典型企业资源整合策略分析 185

一、外部产业链协作 185

二、集约化管理 187

第三节 企业信息化管理 190

一、财务信息化 190

二、生产管理信息化 194

第四节 企业资源整合经典案例 198

第四部分 价格与重点企业分析

第八章 2007-2016年中国智能卡芯片行业市场价格分析及预测 207

第一节 价格形成机制分析	207
第二节 价格影响因素分析	213
第三节 2007-2010年中国智能卡芯片行业平均价格趋向分析	214
第四节 2011-2016年中国智能卡芯片行业价格趋向预测分析	214

第九章 智能卡芯片重点企业分析 215

第一节 上海复旦微电子股份有限公司 215

- 一、企业概况 215
- 二、企业优势 215
- 三、企业产品发展 216

第二节 北京华虹集成电路设计有限责任公司 217

- 一、企业概况 217
- 二、企业产品系列 219

第三节 上海华虹NEC电子有限公司 220

- 一、企业概况 220
- 二、企业发展分析 221

第四节 大唐微电子技术有限公司 226

- 一、企业概况 226
- 二、企业公司资质 227

第五节 中芯国际集成电路制造(上海)有限公 229

- 一、企业概况 229
- 二、企业规模 230
- 三、企业业务范围 230

第六节 杭州士兰微电子股份有限公司 231

- 一、企业概况 231
- 二、企业业务范围 232
- 三、企业经营状况 232
- 四、企业竞争优势 237

第七节 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 238

- 一、企业概况 238
- 二、企业经营状况 239
- 三、企业竞争优势 243

第八节 上海贝岭股份有限公司 244

一、企业概况 244

二、企业经营状况 245

第九节 国民技术股份有限公司 249

一、企业概况 249

二、企业经营状况 250

三、企业竞争优势 254

第十节 西门子股份公司 255

一、企业概述 255

二、企业主要业务 257

第五部分 行业投资分析

第十章 我国智能卡芯片行业投资价值与投资策略咨询 271

第一节 行业SWOT模型分析 271

一、优势分析 271

二、劣势分析 274

三、机会分析 275

四、风险分析 277

第二节 智能卡芯片行业投资价值分析 278

一、智能卡芯片行业发展前景分析 278

二、投资机会分析 286

第三节 智能卡芯片行业投资风险分析 287

一、市场竞争风险 287

二、原材料压力风险分析 288

三、技术风险分析 288

四、政策和体制风险 288

五、外资进入现状及对未来市场的威胁 291

第四节 智能卡芯片行业投资策略分析 291

一、重点投资品种分析 291

二、重点投资地区分析 293

第十一章 智能卡芯片发展前景预测 295

第一节 行业发展趋势预测	295
第二节 2011-2016年行业市场容量预测	300
第三节 影响未来行业发展的主要因素分析预测	300
第四节 未来企业竞争格局	302
第五节 行业资源整合趋势	304
第六节 产业链竞争态势发展预测	306
第七节 博思数据观点	307

第十二章 智能卡芯片行业竞争格局分析 312

第一节 智能卡芯片行业竞争结构分析 312

一、现有企业间竞争 312

二、潜在进入者分析 315

三、替代品分析 315

四、供应商议价能力 315

五、客户议价能力 315

第二节 智能卡芯片行业集中度分析 316

一、市场集中度分析 316

二、企业集中度分析 316

三、区域集中度分析 316

第三节 行业国际竞争力比较 317

一、生产要素 317

二、需求条件 320

三、支援与相关产业 326

四、企业战略、结构与竞争状态 331

第十三章 2011-2016年中国智能卡芯片行业投资风险预警 335

第一节 政策和体制风险 335

第二节 技术发展风险 337

第三节 市场竞争风险 338

第四节 原材料压力风险 338

第五节 博思数据观点 338

图表目录

图表：2010年全国城镇居民主要收支数据变化情况 9

图表：2010年各省（自治区、直辖市）城镇居民可支配收入及消费性支出变化情况 9

图表：2010年2月中国固定资产投资完成额 22

图表：2010年3月中国固定资产投资完成额 22

图表：2010年4月中国固定资产投资完成额 22

图表：2010年5月中国固定资产投资完成额 22

图表：2010年6月中国固定资产投资完成额 23

图表：2010年7月中国固定资产投资完成额 23

图表：2010年8月中国固定资产投资完成额 23

图表：2010年9月中国固定资产投资完成额 23

图表：2010年10月中国固定资产投资完成额 23

图表：2010年11月中国固定资产投资完成额 24

图表：2010年12月中国固定资产投资完成额 24

图表：2011年2月中国固定资产投资完成额 24

图表：2011年3月中国固定资产投资完成额 24

图表：2011年4月中国固定资产投资完成额 24

图表：2011年5月中国固定资产投资完成额 25

图表：2011年6月中国固定资产投资完成额 25

图表：2011年7月中国固定资产投资完成额 25

图表：2011年8月中国固定资产投资完成额 25

图表：2011年9月中国固定资产投资完成额 25

图表：韩国发展半导体产业扶持政策 42

图表：由国家（地区）集中投资的部分重大集成电路项目 42

图表：中国大陆及台湾地区、新加坡半导体鼓励措施的比较 43

图表：2005-2012年中国集成电路市场规模及预测 63

图表：长三角地区IC芯片生产企业 67

图表：环渤海地区IC芯片生产企业 67

图表：珠三角地区IC芯片生产企业 67

图表：东北、西北地区IC芯片生产企业 68

图表：西南及其他地区IC芯片生产企业 68

图表：2010-2011年中国智能芯卡片产量 77

图表：2010年中国智能卡芯片市场容量 77

图表：2006年中国智能卡芯片产量 85

图表：2007年中国智能卡芯片产量 85

图表：2008年中国智能卡芯片产量 85

图表：2009年中国智能卡芯片产量 85

图表：2010年中国智能卡芯片产量 85

图表：2006年中国智能卡芯片消费量 86

图表：2007年中国智能卡芯片消费量 86

图表：2008年中国智能卡芯片消费量 86

图表：2009年中国智能卡芯片消费量 86

图表：2010年中国智能卡芯片消费量 86

图表：2011年中国智能卡芯片产量预测 87

图表：2012年中国智能卡芯片产量预测 87

图表：2013年中国智能卡芯片产量预测 87

图表：2014年中国智能卡芯片产量预测 87

图表：2015年中国智能卡芯片产量预测 87

图表：2011年中国智能卡芯片消费量预测 88

图表：2012年中国智能卡芯片消费量预测 88

图表：2013年中国智能卡芯片消费量预测 88

图表：2014年中国智能卡芯片消费量预测 88

图表：2015年中国智能卡芯片消费量预测 88

图表：RFID工作原理 100

图表：RFID系统的工作频段及技术特点 101

图表：近场支付卡业务特点 103

图表：智能卡安全域结构图 104

图表：仓储物流业务场景 105

图表：仓储物流技术建议 106

图表：近场支付业务场景 107

图表：近场支付技术建议 107

图表：一卡通技术建议 109

图表：2009年中国电信智能卡芯片消费量 112

图表：2010年中国电信智能卡芯片消费量 112

图表：2010年中国智能卡主要厂商及市占率	142
图表：全球智能卡销量区域细分市场份额	143
图表：全球智能卡销量行业应用细分市场份额	144
图表：全球智能卡销量产品类型细分市场份额	145
图表：北京集成电路产业发展	153
图表：深圳集成电路产业发展	154
图表：无锡集成电路产业发展	155
图表：杭州集成电路产业发展	155
图表：苏州集成电路产业发展	156
图表：上海集成电路产业发展	157
图表：2007年中国智能卡芯片市场规模	158
图表：2008年中国智能卡芯片市场规模	158
图表：2009年中国智能卡芯片市场规模	158
图表：2010年中国智能卡芯片市场规模	158
图表：2010年东北智能卡芯片市场规模	159
图表：2010年华北智能卡芯片市场规模	159
图表：2010年华东智能卡芯片市场规模	159
图表：2010年华中智能卡芯片市场规模	159
图表：2010年华南智能卡芯片市场规模	160
图表：2010年西部智能卡芯片市场规模	160
图表：2011年中国智能卡芯片市场规模预测	160
图表：2012年中国智能卡芯片市场规模预测	160
图表：2013年中国智能卡芯片市场规模预测	161
图表：2014年中国智能卡芯片市场规模预测	161
图表：2015年中国智能卡芯片市场规模预测	161
图表：2011年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成	233
图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司每股指标	233
图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司获利能力	234
图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力	234
图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力	234
图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司资本结构	235
图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力	235

图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量 235

图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务收入 235

图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务利润 235

图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司营业利润 236

图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司利润总额 236

图表：2010-2011年杭州士兰微电子股份有限公司净利润 236

图表：2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司主营构成 239

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司每股指标 240

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司获利能力 240

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司经营能力 241

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司偿债能力 241

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司资本结构 241

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司发展能力 241

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司现金流量 241

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司主营业务收入 242

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司主营业务利润 242

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司营业利润 242

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司利润总额 243

图表：2010-2011年唐山晶源裕丰电子股份有限公司净利润 243

图表：2011年上海贝岭股份有限公司主营构成 245

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司每股指标 246

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司获利能力 246

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司经营能力 246

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司偿债能力 246

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司资本结构 247

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司发展能力 247

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司现金流量 247

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司主营业务收入 247

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司主营业务利润 248

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司营业利润 248

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司利润总额 248

图表：2010-2011年上海贝岭股份有限公司净利润 249

图表：2011年国民技术股份有限公司主营构成 250

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司每股指标 251

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司获利能力 251

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司经营能力 252

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司偿债能力 252

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司资本结构 252

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司发展能力 252

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司现金流量 253

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司主营业务收入 253

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司主营业务利润 253

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司营业利润 253

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司利润总额 254

图表：2010-2011年国民技术股份有限公司净利润 254

图表：2011-2016年中国智能卡芯片市场容量 300

图表：芯片设计业的主要厂家及产品表 312

图表：芯片加工业的主要厂家及产品 315

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国务院发展研究中心、中国半导体行业协会、国内外相关刊物杂志的基础信息以及智能卡芯片研究单位等公布和提供的大量资料，结合博思公司对智能卡芯片相关企业的实地调查，对我国智能卡芯片行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、价格走势与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了智能卡芯片行业的前景与风险。报告揭示了智能卡芯片市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/yingjian1111/M365104P11.html>